LION BMS

İş Pal	ketleri		
1A		Proje Süreci	MİRAY
1B		BMS Donanım Geliştirme	İLKSEN
		Battery cell characterization board development:	
	1B1	Charge and discharge circuit	İlksen
	1B2	Protection circuits	İlksen/Miray
	1B3	Analog simulation (LTspice, Orcad)	Ege
	1B4	Schematic and PCB design (Altium Designer or Kicad)	Miray
	1B5	Board manufacturing	Ege
1C		BMS Algoritması Geliştirme	MELİH
		SoC, SoH - Matlab Simulink, m-file	İlksen/Miray
1D		Mikrodenetleyici programlama	EGE
	1D1	STM32 mikrodenetleyici seçimi	Ege/Miray
	1D2	Algoritmanın C'de uygulanması	Melih/İlksen
1E		Yazılım (GUI) Geliştirme	MELİH
		Qt gibi kütüphanlerden arayüz tasarımı	
		Socket programming (UART)	

İş Paketi Adı	1A Proje Süreci
Sorumlu Kişi	Miray Dönertaş

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Bu iş paketinde proje ilerleyişinde gereken iş yükü çalışma saatlerinin planlanması, eksiklikler için ek süre sağlanması ve var olan sapmaların tespiti ve önlemlerin alınması ,koordinasyonlu bir şekilde ekip arkadaşlarının bilgi alışverişinde bulunması ve proje donem raporlarinin hazirlanmasi faaliyetleri gerceklestirecektir.

2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Proje verileri olan raporlar ve birimler ile is paketleri arasındaki es zamanlı paylaşı ve birikim saglanacaktır. Projeye dair yapılması gereken başvurular ve alınan kararlar ile gerçekleşen durumlar bu iş paketi aracılığıyla sağlanacaktır

İş Paketi Adı	1B1 Charge and discharge circuit
Sorumlu Kişi	İlksen Dilek Keskin

1-iş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.	
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.	
2 is pareeting randimator yetheriner to inscreme and parametricient instelleying.	

İş Paketi Adı	1B2 Protection circuits
Sorumlu Kişi	İlksen Dilek Keskin /Miray Dönertaş

1-iş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.

İş Paketi Adı	1B3 Analog simulation (LTspice, Orcad)
Sorumlu Kişi	Ege Ertekin

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.	
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.	
2 13 paketinae kananinaeak yontermer ve meelenedek parametrelen noteleyinizi	

İş Paketi Adı	1B4 Schematic and PCB design (Altium Designer or Kicad)
Sorumlu Kişi	Miray Dönertaş

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.	
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.	

İş Paketi Adı	1B5 Board manufacturing
Sorumlu Kişi	Ege Ertekin

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

İş Paketi Adı	1C BMS Algoritması Geliştirme
Sorumlu Kişi	Melih Akıncı/İlksen Dilek Keskin/Miray Dönertaş

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.	
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.	
2 - is paketilide kullallilacak yoliteriller ve iliceleriecek parallietreleri listeleyilliz.	

İş Paketi Adı	1D1 STM32 mikrodenetleyici seçimi
Sorumlu Kişi	Ege Ertekin/ Miray Dönertaş

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.

İş Paketi Adı	1D2 Algoritmanın C'de uygulanması
Sorumlu Kişi	Melih Akıncı/ İlksen Dilek Keskin

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
2. Is nakatinda kullanilasak vantamlar va insalanasak naramatralari listalaviniz
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.

İş Paketi Adı	1E Yazılım (GUI) Geliştirme
Sorumlu Kişi	Melih Akıncı

1-İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.	
2 - Is paketinde kullanilacak yontemler ve incelenecek parametreleri listeleyiniz.	